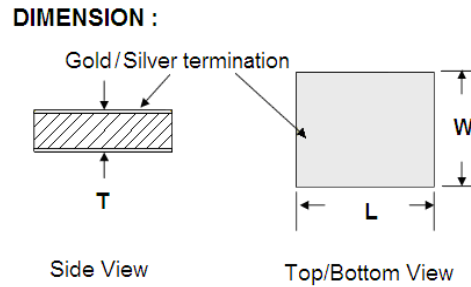


## 金电极系列 NTC 热敏芯片-邦定专用 NTC 热敏芯片



### 特点

DT 系列 NTC 金电极热敏芯片是采用金浆作为表面电极的高可靠芯片，适合混合设计多功能模块或高可靠 NTC 温度传感器的制作。

- 使用寿命长，可靠性、稳定性高
- 体积小，响应速度快，适合狭小空间中使用（集成到温度模块中）
- 良好的耐热循环能力
- 适合邦定工艺安装
- 工作温度  $-50\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +200\text{ }^{\circ}\text{C}$

### 应用范围

- 混合设计多功能模块
- 汽车（温度模块）、医疗传感器（手术无影灯，光电传感器）的制作
- 办公设备上用温度模块（热敏打印头等）
- 智能家居上用（可测人体体温的空调，冰箱。。。）
- 高精度 NTC 温度传感器的制作
- 可根据客户要求定做特殊规格。

### 产品规格型号表示方法

<b>DT</b>	<b>103</b>	<b>F</b>	<b>3435</b>	<b>A</b>	<b>-</b>	<b>G</b>
①	②	③	④	⑤		⑥

①		②		③		④	⑤		⑥	
产品代号		25°C电阻值		R25 误差		B 值	B 值测量温度		电极材质	
DT	DT 系数 热敏电阻	20	20× 10 <sup>2</sup> Ω	F	± 1%	3435: B=343 5	A	25°C/50°C	G	
		3	10× 10 <sup>3</sup> Ω	G	± 2%		4100: B=410 0	B		
		47	47× 10 <sup>3</sup> Ω	H	± 3%	3964 B=396 4		C		
3		J	± 5%	E	0°C/50°C		S			
						F			0°C/100°C	
								25°C/100 °C		

## 电性能参数

型号	标称值 (KΩ)	B 值 (K)	额定功率 (mW)	耗散系数(δ) (mW/°C)	热时间常数 (S)
DT303□3695F-G	30.0	3964	15	2.5	≤15
DT104□3964-G	100.0	3964			

## 安装方式

- 1.常用方式：邦定（铝线或金线）
- 2.邦定效果图及拉力测试（拉力测试：1 mil 铝结邦定，拉力≥5g 以上，拉力测试后为断线）后图片：

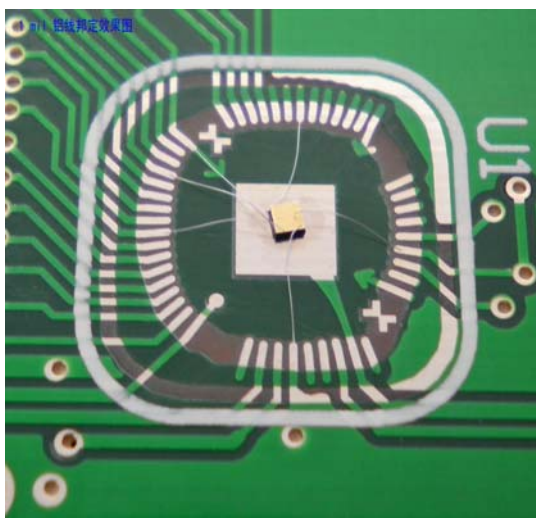


图 1： 邦定效果图

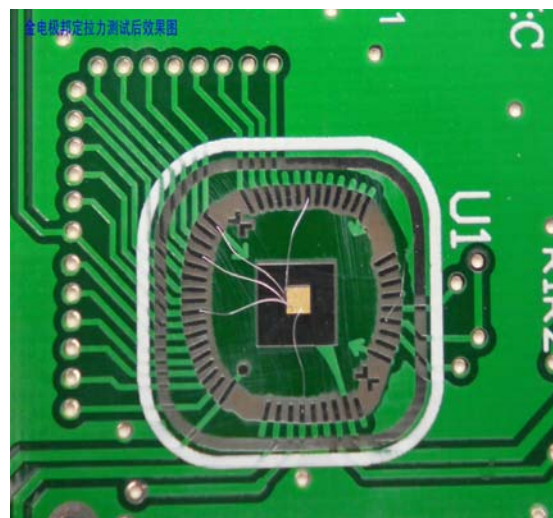


图 2： 拉力测试后图片（断线）

